



激光锡球喷射焊接机简介



产品介绍:

激光通过光纤传输，输出口安装于锡球出口上方，在环形腔体上放置有供高压气进入的入口，通过激光融化锡球，然后高压惰性气体可保证有足够的压力将熔化的锡球滴落，又可以保证熔化的焊锡不会被氧化，焊接精度高，焊接效果好，尤其适用于极高精度的焊锡需求。



产品特点:

适用于高精度焊接，精度 $\pm 10\mu\text{m}$ ，产品最小间隙 100 μm ；

锡球范围可供选择范围大，直径 0.25mm；

应用于镀锡、金、银的金属表面，良率 99%以上。

技术优点:

加热、熔滴过程快速，可在 0.2s 内完成；

在焊嘴内完成锡球熔化，无飞溅；

不需助焊剂、无污染，最大限度保证电子器件寿命；

锡球直径最小 0.1mm，符合集成化、精密化发展趋势；

可通过锡球大小的选择完成不同焊点的焊接；

焊接质量稳定，良品率高；

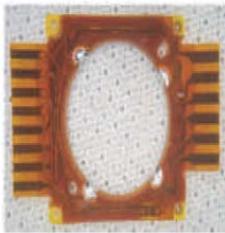
配合 CCD 定位系统适合流水线大批量生产需求。

应用领域:

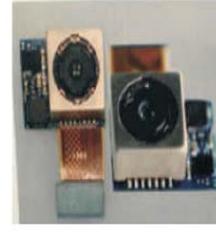
微电子行业：高清摄像模组、手机数码相机软板连接点焊接、精密声控器件、数据线焊点组装焊接、传感器焊接。

军工电子制造行业：航空航天高精密电子产品焊接。

其他行业：晶圆、光电子产品、MEMS、传感器生产、BGA、HDD (HGA, HSA) 等高精密部件、高精密电子的焊接。



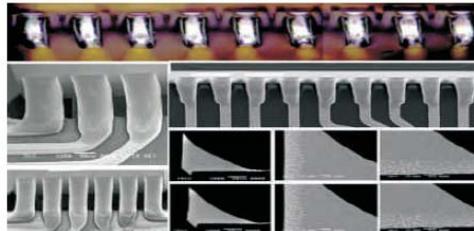
OIS底座-FPC簧片焊接



VCM模组(角度焊接)



OIS吊环线焊接



HDD:焊盘宽度0.08mm,间距最小0.1mm

技术参数

送料方式	载盘进出或轨道在线式或治具单、双工位
激光参数	功率: 50-200W 可选
	波长: 1070±5nm
	模式: 连续/脉冲
锡球规格	Ø0.25mm
控制方式	PLC 动作+PC 图像处理
机械重复精度	±0.003mm
视觉定位系统	CCD: 5Million Pixels
	解析度: ±5um
外形尺寸	1250*950*1650mm
载盘尺寸	<110*130mm
主机重量	550kg
功耗	3kw
电源	单相 AC220V, 15A
压缩气	0.6MPa